

鈦昇科技股份有限公司



股票代號：8027
網址：<http://www.enr.com.tw>



公司簡介

鈦昇科技股份有限公司自 83 年成立以來即專注於研發生產 IC 封裝自動化設備，並於 87 年開始配合工研院逐步發展 IC 封裝製程中電漿清洗機及雷射打印設備，於雷射領域研究 20 載，103 年利用雷射微加工技術更順利切入美系客戶的第一代穿戴式裝置供應鏈。目前鈦昇公司相關雷射設備主要有：雷射打印機、SiP 雷射切割機、雷射鑽孔機，亦提供應用於 LED 產業的電漿清洗設備、軟板產業的濕製程設備與捲對捲／片對片製程設備。此外，另生產應用於半導體的 SMD (Surface Mount Device 表面黏著元件) 包裝材料。鈦昇公司秉持著「卓越與信賴」的經營理念，在卓越方面：以人為本，以科技創新為體；在信賴方面：善待員工與股東、善待客戶、善待供應鏈、善待社會，以誠信經營的態度，落實企業社會責任。「善念、圓融、同舟共濟；創新、突破、徹底執行。」更為鈦昇公司一貫的信念。

產業現況與發展

物聯網概念的出現，未來電子產業的應用將連結各大產業，包括從消費性電子產品到汽車、居家防盜至醫療臨床等，藉由至智慧型手機的普及到雲端軟體及基礎建設及感測器的進步，將帶給人類更大的

便利，舉凡消費者對穿戴裝置的輕薄短小、多方感測器、省電、廉價、快速及美觀的要求，以及搭配雲端構想及基礎建設的強化，無不增加對半導體供應鏈之需求，並促進半導體製程與技術的不斷升級，根據國際研究暨顧問機構 Gartner 市調機構之預估，不包含 PC、平板及智慧型手機在內的物聯網 (Internet of Things, IoT) 裝置用戶數，估計將於 2020 年成長至 260 億台／支，較 2009 年的 9 億台／支，成長近 30 倍，新需求的出現與技術的日新月異，均為全球半導體市場的持續成長帶來源源不絕之動力。行動裝置和行動支付之指紋辨識朝輕薄化發展下，內部 IC 亦需進行輕薄化與整合化，故持續導入 SiP 封裝為勢在必行，然傳統加工方式容易造成 IC 破裂或缺損，再加上晶片也朝不規則形狀發展，將帶動如雷射切割、挖溝、修邊…等雷射加工需求快速提升。

競爭優勢

1. 技術獲國際大廠認可

鈦昇公司自行研發之新雷射微加工設備自推出市場以來，因其掌握冷加工的頂尖技術，具備高精準

度及優於同業之加工速度，且在雷射功率與外光路設計能力優異，已順利切入美系客戶的第一代穿戴式裝置供應鏈。

2. 位處全球最大 IC 封裝研發基地附近，配合客戶研發新技術，迅速切入市場

鈦昇公司利用在地化優勢，在發展初期即與全球最大封裝集團進行設備研發，具有先行者優勢，順利切入美系穿戴式裝置的相關設備供應鏈，並成為重要供應商。由於進入門檻高，更有利鈦昇公司持續切入下一代產品供應鏈中。

3. 產品及產業多樣性

鈦昇公司在美系客戶供應鏈中除了提供應用於 SiP 封裝後的雷射切割外，也提供其他封裝過程中的相關設備，例如：粉塵清洗機、雷射打印機等。此外半導體製程高階封裝需求持續提升，再加上晶片成本隨著製程微縮而增加，晶圓代工業者為了降低客戶成本，持續發展晶圓等級的封裝技術，及發展出應用於晶圓等級封裝的微波電漿清洗機。隨著 iPhone 5S 納入指紋辨識晶片後，藍寶石基板的應用往 home 鍵進行發展，且隨著非蘋陣營行動裝置陣營將指紋辨識晶片納入，藍寶石基板需求將快速提升，帶動藍寶石切割機需求，鈦昇公司也藉由推出性價比更高的藍寶石雷射切割設備進軍中國市場。

4. 研發能量大，可迅速投入新產品研發，領先市場

鈦昇公司相當重視產品研發，研發部門員工人數占全公司員工人數之 46%，透過建教合作與申請替代役方式擴大人才網羅之管道，加強專業培訓，並密切與研究機構或學術單位技術交流，持續改善生產技術、降低成本、積極開發各項有利基之新產品，使產品多元化，跨足不同之產業領域，提升市場占有率。



本中心李啓賢總經理（右）致贈紀念品予鈦昇公司王明慶董事長（左），恭賀上櫃掛牌成功。（104.6.9）

5. 密集設置服務據點，提供客戶迅速而有效之服務

鈦昇公司於台灣、大陸及東南亞皆設有服務據點，以充分專業之技術諮詢，對客戶就近提供完善服務，提高客戶對公司產品的滿意度。

未來展望

鈦昇公司因長期與全球最大封裝集團合作開發應用於 SiP 封裝的雷射設備，產品深受肯定，隨著美系客戶在其行動裝置持續採用更多的 SiP 封裝模組，未來該集團將持續擴充 SiP 封裝產能。再加上第二大封裝集團也開始慢慢將重心轉往 SiP 封裝，鈦昇公司雷射切割設備具有先行者的優勢，相關雷射切割設備需求也將同步增加。鈦昇公司不斷藉由其雷射技術優勢進行集團內部資源整合，逐步發展結合雷射鑽孔軟板設備及善用雷射微細加工特性，積極將該設備應用於 LED 陶瓷鑽孔、軟性及硬性電路板雷射鑽孔等多層次應用，且發展更微細之 SMD 包裝材料及設備，逐步滲入各大封裝及軟板市場，憑藉鈦昇公司優異之創新及研發能力，並積極擴展產品應用層面，其預期未來營運成長動能充沛。